

AVANTAGES CONCURRENTIELS

- Atteinte **d'une précision de motif de l'ordre du μm** par lithographie UV ;
- **Homogénéité de la surface finale** du produit obtenu ;
- **Chute du taux de rebut** dans la fabrication ;
- **Baisse du coût de fabrication** ;
- **Utilisation des équipements de microélectronique classique** (substrat rigide) pour application sur substrat souple.

APPLICATIONS/MARCHES

- Microélectronique sur substrat souple ;
- Microtechnologies, par exemple : Capteurs souples de déformation, contrainte, courbure, vibration ;
- LED et OLED sur support souple.

PROPRIETE INTELLECTUELLE

- Savoir-faire secret.

LABORATOIRE

- Institut Jean Lamour

CONTACT

Ludovic GOBY
Ingénieur développement
Matériaux, Procédés, Chimie
Tél. : 03.80.40.34.97 - 06.43.65.51.20
Mél : ludovic.goby@sattge.fr

PRESENTATION

Cette **nouvelle méthode de rigidification temporaire de films souples** permet leur **structuration, leur métallisation, le dépôt de couche par enduction centrifuge, le bain, l'impression (...)**, dans le but de modifier la surface dudit substrat. Cette structuration de films souples se fait de façon homogène sur de grandes surfaces.

